文章编号: 0258-7025(2009)Supplement 2-0011-03

高性能高光束质量 808 nm 锥形半导体激光器

李辉刘国军曲轶王玉霞李梅芦鹏乔忠良

(长春理工大学高功率半导体激光国家重点实验室, 吉林 长春 130022)

摘要 自由空间激光通信由于其具有数据传输容量大、传输路径的高度方向性、高保密性的固有优点,使其成为下 一代光通信技术的发展方向之一。锥形半导体激光器是自由空间激光通信系统中最重要的光源。主要介绍 808 nm锥形半导体激光器的外延结构设计、输出特性、光束质量等。制作的器件总腔长为 3.5 mm(脊形长度为 800 μm,锥形区长度为 2.7 mm),阈值电流为 750 mA,斜率效率为 0.615 W/A,锥形角度为 6°。利用电子束镀膜机 在后腔面蒸镀 Si 和 SiO₂ 高反膜(反射率为 95%),在前腔面蒸镀单层 SiON(反射率< 1%)。在输出功率为 2 W 条 件下,水平发散角为 3.9°,垂直发散角为 40°, M² = 1.8,说明器件具有较好的光束质量。

关键词 激光器;脊形波导;锥形半导体激光器;M²因子

中图分类号 TN 248.4 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL200936s2.0011

High Performance High Beam Quality 808 nm Tapered Semiconductor Lasers

Li Hui Liu Guojun Qu Yi Wang Yuxia Li Mei Lu Peng Qiao Zhongliang (National Key Laboratory on High Power Semiconductor Lasers, Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin 130022, China)

Abstract The free space laser communication has advantages of large data transmission amount, high direction of transmission and high transmission security. It has become one of the developing directions of next generation optical communication technologies. The tapered semiconductor lasers are the most important optical sources in the free space laser communication. In this paper, it has introduced the structure design, output characteristics and beam quality of 808 nm tapered semiconductor lasers. The total laser cavity length is 3.5 mm (tapered single emitters consist of a ridge section with a length of 800 μ m and a tapered section with a length of 2.7 mm, the tapered angle is 6°). Si and SiO₂ (95% reflectivity) are deposited at the rear facet with the help of electronic beam evaporator. The front facet is coated with a single layer of SiON (<1% reflectivity). The threshold current of the device is 0.75 A. The maximum slope efficiency is 0.615 W/A. The output power of the device reaches 2 W, horizontal divergence is 3.9°, vertical divergence is 40° and M^2 factor is less than 1.8. It shows the device has good beam quality. **Key words** lasers; ridged wave-guide; tapered semiconductor lasers; M^2 factor

1 引 言

自由空间激光通信由于其具有数据传输容量 大、传输路径的高度方向性、高保密性等优点,使得 自由空间(地面-地面,卫星-地面,卫星-卫星)激光通 信技术成为下一代光通信技术的发展方向之一。半 导体激光器由于其具有体积小、重量轻、效率高、可 靠性高、可直接调制等优点,成为空间激光通信的理 想光源。此外在高功率半导体激光器其他的一些应 用领域,例如抽运稀土掺杂的光纤放大器、非线性频 谱学等同样需要高功率和近衍射极限的光束质量。 采用单片集成主振荡功率放大器结构的锥形半导体 激光器,不仅可以输出瓦级高亮度光(M²<4),而且 波长范围覆盖 0.65~9 μm^[1~8]。

现在 808 nm 锥形半导体激光器已经成为国外研究的热点。2006 年, F. Dittmar 等^[9]研制出808 nm锥形近衍射极限半导体激光器。器件采用2 μ m波导厚度的大光腔结构,总腔长 2.75 nm。其中脊形区宽度 3 μ m,长度 750 μ m,器件的垂直发散角为 26°,在

E-mail: lihui8382@126.com

基金项目:国家自然科学基金(60677008),高功率半导体激光国家重点实验室基金(9140C3102060703)资助课题。

作者简介:李 辉(1971—),女,助理研究员,硕士,主要从事半导体激光器件工艺及制作等方面的研究。

4.4 W输出功率时, M^2 因子为1.9, 亮度达到 460 MW/cm² sr⁻¹。2007年, Frank Dittmar等^[10]研制 出808 nm脉冲输出9W的超大光腔近衍射极限半 导体激光器, 垂直发散角仅为18°。

国内在 808 nm 近衍射极限光束质量的锥形半 导体激光器研究方面未见报道。只有 2005 年中国 科学院半导体研究所的张洪波等^[11]利用 MOCVD 生长了 14xxnm AlGaInAs/AlInAs/ InP 应变量子 阱外延片。采用带有锥形增益区脊型波导结构制作 1.2 nm 腔长的器件,器件功率达到 500 mW,饱和 电流 3 A 以上,峰值波长 1460 nm,远场发散角为 $39^{\circ} \times 11^{\circ}$ 。2007 年中国科学院半导体研究所的李璟 等^[12]研制出脊形波导区和锥形区电极分离980 nm 锥形激光器。发现电极分离的 980 nm 锥形激光器 的 *P-I* 特性曲线比较光滑,没有明显的扭折。器件 的最大功率达到 4.28 W, $M^2 = 2.45$ (输出功率为 1 W时)。本文介绍采用带有锥形增益区脊型波导 结构制作 808 nm 锥形半导体激光器,达到2 W连续 功率的近衍射极限输出。

2 半导体激光器的外延结构设计与 生长

利用分子東外延设备生长半导体激光器材料,外 延片衬底采用(100)面偏向 $\langle 111 \rangle$ A4°的 n-GaAs(Si 掺, 1~2×10¹⁸ cm⁻³)低位错密度衬底($\leq 100 \text{ cm}^{-2}$)。结构 依次为:1.0 µm n-GaAs(Si 掺,1.0×10¹⁸ cm⁻³)缓冲层, 0.2 µm N-Al_{0.1-0.5} Ga_{0.9-0.5} As (Si 掺, 约 1.0× 10¹⁸ cm⁻³)渐变过渡层,1.2 µm N-Al_{0.5} Ga_{0.5} As(Si 掺, 1.0×10¹⁸ cm⁻³)下限制层,0.1 µm 非故意掺杂 Al_{0.3} Ga_{0.7} As 波导层,7 nm 非故意掺杂 Al_{0.3} Ga_{0.7} As 波导层, 1.2 µm P-Al_{0.5}Ga_{0.5} As(Be 掺,1.0×10¹⁸ cm⁻³)上限制 层,0.3 µm P-GaAs(Be 掺,0.1→2.0×10¹⁹ cm⁻³)欧姆 接触层。材料生长过程中保持 GaAs 组分的生长速率 不变,为1 µm/h。对 GaAs 的生长,V/III 束流比保持 在近临界状态,约为 8~10,对 AlGaAs 的生长,V/III束 流比保持在 5~6。

3 锥形半导体激光器的制作

锥形半导体激光器由两部分组成:单模低功率 的主振激光器、锥形半导体激光放大器。锥形半导 体激光器器件结构如图 1 所示,器件的总腔长为 3.5 mm(脊形长度为 800 μm,锥形区长度为 2.7 mm),在脊形单模主振荡器与锥形放大器的耦 合区域设计两个倾斜条形的腔破坏凹槽,抑制器件 在锥形增益区之外的电流非注入区形成的法布里-珀罗(Fabry-Perot)腔。





3.1 锥形半导体激光器件制作工艺

在锥形半导体激光器的实际制作中,锥形增益 区的张角以及窄端宽度的选择主要考虑与入射光的 发散角相匹配。对于条宽为 2~5 μm 的脊形波导 其出射光的衍射角为 4°~6°。为此选择锥形增益区 张角为 6°,脊形波导区域条宽为 5 μm。

锥形半导体激光器制作工艺流程大致可以分为:光刻与腐蚀,非注入区 SiO₂ 绝缘膜的淀积,liftoff,溅射 p⁺ 面 Ti/Pt/Au 层,减薄,溅射 n 面 Au, Ge/Ni 层,金属化,溅射 n 面 Ti/Pt/Au 层,解理,腔 面镀膜,单管芯解理,焊装,测试等步骤。首先光刻 出锥形区域,然后二次光刻出脊形部分,脊形条宽 为 5 μ m,经过 3 次光刻,利用等离子体电感耦合 (ICP)腐蚀出腔破坏凹槽窗口,并利用磁控溅射在 p⁺面溅射 100 nm Ti/100 nm Pt/200 nmAu 形成 p 型欧姆接触区,之后外延片减薄至 110 μ m,利用磁 控溅射在 n 面溅射100 nm AuGe/100 nm Ni,随后 在氢气气氛下以 420 ℃合金,利用磁控溅射在 n 面 溅射 200 nmAu,利用划片解理机进行条解理,利用 电子束镀膜机在器件前腔面蒸镀单层 SiON(反射



图 2 锥形半导体激光器芯片 p 面照片 Fig. 2 Photo of the p side of tapered diode laser chip

率<1%),在后腔面蒸镀Si和SiO₂高反膜(反射率为95%),之后解理成管芯。

3.2 锥形半导体激光器件特性

解理好的器件 p 面朝上采用 AuSn 合金焊接到 AlN 热沉上。利用安装在积分球上的经校准的探 测器对输出功率与注入电流的特性进行测量。器件 的远场和 *P-I* 特性分布如图 3,4 所示,激光器 *M*² 因子随输出功率变化曲线如图 5 所示。器件在室温 阈值电流为 750 mA,斜率效率为0.615 W/A,锥形 角度为 6°,在输出功率为 2 W 条件下,水平发散角 为 3.9°,垂直发散角为 40°,*M*²=1.8,表明器件具有 较好的光束质量。



图 3 激光器的远场分布





图 4 激光器的功率电流曲线

Fig. 4 Power-current curve of the tapered laser

4 结 论

采用带有锥形增益区脊型的波导结构,制作出高 功率高光束质量 808 nm 锥形半导体激光器。器件在 总腔长 3.5 mm(5 μm 脊形条宽,长度为 800 μm,锥形 区长度为 2.7 mm)时,阈值电流为 750 mA,最大输出 功率达到 2 W,斜率效率为 0.615 W/A,水平发散角 为 3.9°,垂直发散角为 40°, M² 为 1.8。



图 5 锥形半导体激光器 M² 因子随输出功率的变化曲线 Fig. 5 Curve of M² and output power of the tapered diode laser



- 1 Bernd Sumpf, Gert Beister, Götz Erbert *et al.*. Reliable 1 W CW operation of high-brightness tapered diode lasers at 735 nm[J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2004, **16**(4), 984~986
- 2 Pawel Adamiec, Bernd Sumpf, David Feise *et al.*. Twin-contact 645 nm tapered laser with 500 mW output power [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2009, **21**(4): 236~238
- 3 C. Fiebig, G. Blume, C. Kaspari *et al.*, 12 W high-brightness single-frequencey DBR tapered diode laser[J]. *Electron. Lett.*, 2008, 44(21): 1253~1255
- 4 J. N. Walpole, Fellow, J. P. Donnelly *et al.*. Gaussian patterned contacts for improved beam stability of 1.55 μ m tapered lasers [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2000, **12** (3): 257~259
- 5 S. R. 'Selmic', G. A. Evans, T. M. Chou *et al.*. Single frequency 1550 nm AlGaInAs-InP tapered high-power laser with a distributed Bragg reflector [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2002, 14(7): 890~892
- 6 J. N. Walpole, H. K. Choi, L. J. Missaggia *et al.*. High-power high-brightness GaInAsSb-AlGaAsSb tapered laser arrays with anamorphic collimating lenses emitting at 2.05 μ m [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 1999, **11**(10): 1223~1225
- 7 Lars Nähle, Julia Semmel, Wolfgang Kaiser *et al.*. Tapered quantum cascade lasers [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2007, 91(18): 181122-1~181122-3
- 8 Mirjam Müller, Adam Bauer, Thomas Lehnhardt *et al.*. Highpower frequency stabilized GaSb DBR tapered laser[J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2008, **20**(24): 2162~2164
- 9 F. Dittmar, B. Sumpf, J. Fricke *et al.*. High-power 808 nm tapered diode lasers with nearly diffraction-limited beam quality of $M^2 = 1.9$ at P = 4.4 W[J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2006, **18**(4): $601 \sim 603$
- 10 Frank Dittmar, Andreas Klehr, Bernd Sumpf et al., 9 W output power from an 808 nm tapered diode laser in pulse mode operation with nearly diffraction-limited beam quality [J]. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 2007, 13(15): 1194~1199
- 11 Zhang Hongbo, Wei Xin, Zhu Xiaopeng et al.. 14xxnm quantum well lasers with tapered gain region [J]. Acta Photonica Sinica, 2005, 34(4): 497~498
 张洪波,韦 欣,朱晓鹏等. 带有锥形增益区 14xxnm 量子阱激光器的研制 [J]. 光子学报, 2005, 34(4): 497~498
- 12 Li Jing, Liu Yuanyuan, Ma Xiaoyu *et al.*. High-brightness tapered diode lasers emitting at 980 nm with electrically separated ridge waveguide and tapered section [J]. *Chinese J. Semiconductors*, 2007, **28**(8): 1303~1305
 - 李 璟,刘媛媛,马骁宇. 电极分离的 980 nm 锥形激光器的研制[J]. 半导体学报,2007,28(8):1303~1305